

上海骄成超声波技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-016

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	中银国际证券、中信证券、易米基金、磐稳投资、博裕资本、凯思博投资、复胜资产、名禹资产、西部利得基金、申万菱信基金、君成投资、汇添富基金、誉辉资本、卜筑私募、基明资本、永灵通投资、兴业证券、中欧基金、招商基金、天治基金、惠升基金、农银汇理、尚善资产、鹏扬基金、中银基金、浙商资管、华泰证券自营、景顺长城基金、睿亿投资、招商证券、浙商证券、泉果基金、承珞资本、光大保德信基金、华泰保兴基金、五地基金、玖润投资、方正证券
会议时间	2025 年 10 月 20 日、2025 年 10 月 21 日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：孙凯 证券事务代表：彭芹芹
投资者关系活动主要内容介绍	Q1、请问公司在半导体领域都有哪些产品布局？ A1、在功率半导体领域，公司有超声波端子焊接机、超声波PIN 针焊接机、超声波键合机、超声波扫描显微镜等全工序超声波解决方案，并均已实现批量出货。在半导体先进封装领域，公司大力推动先进超声波扫描显微镜以及超声波固晶机（超声热压焊机）等新产品设备的研发和推广，公司先进封装相关业务正持续突破技术与市场边界，加速向规模化应用迈进。

	Q2、半导体领域超声波检测和 X 光检测是否存在替代关系？ A2、在半导体先进封装领域，超声波检测与 X 射线均能够检测工件内部缺陷，X 射线检测的优势在于检测存在密度差异的缺陷，超声波检测则对声阻抗差异敏感，对于内部的平面型缺陷或界面缺陷，如裂纹、未熔合、界面分层等情况，超声波的反射特性优势明显，超声波在界面会大量反射，产生极其强烈的回波信号，利用界面声阻抗差异，超声波检测技术可精准、无损伤地探测出半导体晶圆、2.5D/3D 封装、芯片贴装等内部缺陷。整体上，超声波检测与 X 光检测存在应用场景差异，在半导体晶圆、2.5D/3D 封装、芯片贴装等领域，超声波检测拥有难以替代的优势。 Q3、在半导体领域有哪些竞争对手？ A3、在半导体封测环节，核心超声波设备国产化率较低，进口设备如 K&S、ASM、德国 PVA、美国 Sonoscan 在超声波键合机、超声波扫描显微镜等领域占有较高市场份额。公司凭借自身在超声波行业多年的技术积累，紧跟国内半导体产业升级发展需求和技术发展趋势，逐渐打破行业内外资竞争对手的垄断局面，市场份额呈逐渐上升的趋势。 Q4、公司配件使用周期情况以及发展趋势如何？ A4、公司设备相关的配件包括焊头、底模、裁刀、劈刀、发生器、换能器等，一般情况下焊头及底模使用周期为 1-2 个月左右，换能器使用周期为 1 年左右。近年来，公司配件业务收入占比逐步提升，后续随着线束连接器超声波设备、半导体设备业务持续扩展，市场上存量的公司设备增多，以及公司针对焊头、底模、裁刀等配件加大研发力度并进行工艺改进和成本管控，该业务有望持续增长。 Q5、在固态电池领域超声波技术有哪些应用？ A5、公司密切关注新能源领域前沿技术发展趋势，在固态电池领域推出了超声波极耳焊接、超声波检测等多款设备，积极
--	---

	延伸超声技术应用场景，打开更广阔的市场空间。 Q6、超声波固晶机目前进展情况如何？与传统固晶机的区别？ A6、公司大力推动先进超声波扫描显微镜以及超声波固晶机（超声热压焊机）等新产品设备的研发和推广，公司超声波固晶机（超声热压焊机）已获得客户正式订单。传统固晶机主要依赖外部加热和机械压力实现机械连接和电气连接。超声波固晶机则在此基础上进一步引入了超声波能量，在压力下超声波振动传递到芯片与基板的接触界面使金属原子间相互扩散，形成牢固的金属键合。与传统工艺相比，公司超声波热压固晶机采用自主创新的超声波键合技术，通过高频超声波振动，在芯片与基板界面处产生局部加热并清除表面氧化物，促使材料原子级扩散和接触。在超声能量与精确压力协同作用下，界面发生塑性形变和原子扩散，形成牢固的金属键合，大幅提升封装可靠性和生产效率。公司超声波热压固晶机仅需较低预加热温度，即可实现优质键合效果，可以降低热敏感元件损伤风险，具有效率高、能耗低等显著优势，在光通讯、5G 射频、滤波器、激光器、分立器件、存储、AR/VR、MEMS 等领域具有较大的应用前景。 Q7、公司在先进封装领域还有哪些设备布局？ A7、公司积极布局 IC 封装领域，着力研发高端超声波固晶机及球焊机。超声波球焊机运用超声波焊线技术，通过施加压力、热与超声，使微细金线精准连接 IC 芯片电极与框架焊盘，完成芯片封装前的内部引线焊接。依托公司在超声波领域多年技术积淀与经验丰富的研发团队，目前该设备设计与开发工作进展顺利，旨在突破海外厂商在该领域的长期垄断局面。 Q8、除了半导体先进封装领域业务，其他业务还有哪些？ A8、公司作为以超声波技术为核心的技术平台型企业，拥有向下游不同行业进行应用拓展的能力，根据下游不同行业的需
--	--

	求开发出满足应用要求的各类超声波设备和配件。目前公司主要产品包括新能源电池超声波焊接设备、线束连接器超声波焊接设备、半导体超声波焊接设备及相关配件，相关产品主要应用于新能源、半导体等领域，公司持续拓展超声波技术在半导体先进封装、医疗等领域的应用，完善公司产品线，促进业务可持续发展。 Q9、公司线束连接器超声波设备应用在哪些场景以及近期业务情况如何？ A9、在线束连接器领域，公司产品广泛应用于新能源汽车高低压线束、充电桩、储能等领域，比如新能源汽车连接线、充电桩连接线、超充连接线、储能场景等。公司在现有优势产品基础上，积极把握下游市场对高电压、大电流等技术升级带来的新需求，持续拓展线束连接器超声波设备种类覆盖范围。随着下游汽车电动化与智能化、新能源、数据中心等应用行业需求增长，为上游超声波设备厂商提供了良好的发展机遇。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 10 月 21 日